課題番号 :F-16-BA-0056

利用形態 :技術代行

利用課題名(日本語) :Ga イオンビームエッチングによる微細光導波路型ミラーの作製検討

Program Title (English) : Fabrication of waveguide-type micro mirrors by Ga ion beam etching

利用者名(日本語) : 勝山 俊夫

Username (English) : <u>T. Katsuyama</u>

所属名(日本語) :福井大学産学官連携本部

Affiliation (English) : Headquarter for Innovative Society-Academia Cooperation, University of Fukui

1. 概要(Summary)

レーザ光を利用した超小型レーザディスプレイ実現のため、光導波路をベースとした集積化 3 原色合波器と半導体レーザをハイブリッド集積化する構造を検討している。この場合、光ビームを急角度で曲げる必要があり、このため光導波路型全反射ミラーを、Ga イオンビームエッチングで形成する検討を進めた。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

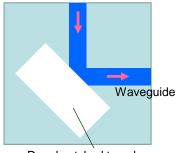
·FIB-SEM (FEI 社, Helios NanoLab 600i)

【実験方法】

SOI (Silicon on Insulator)上に形成した、断面が $2 \times 2 \mu m$ の GeO_2 -Si O_2 矩形コアと、厚さ $20 \mu m$ の SiO_2 ガラスオーバークラッド層からなる光導波路を加工する。 Fig. 1 に示したように、光導波路を 90° 直角に曲げて、その曲げた部分にトレンチ構造を形成する。その結果、トレンチの側壁部分の光の全反射で、光が導波路から漏れることなく伝搬することができる。

このトレンチの形成を、FIB-SEM を用いた Ga イオン ビームエッチングで行う。このエッチングは、光導波路コア 自体は見えないので、光導波路と同じリッジパターンをオ ーバークラッド層の上に形成し、それを目印として、精度 0.5 μm 以下で加工した。

Waveguide

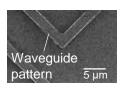


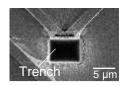
Deeply etched trench

Fig. 1. Laser beam bending by a trench structure.

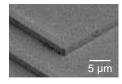
3. 結果と考察 (Results and Discussion)

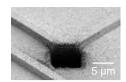
FIB-SEM 装置を用いて、Ga イオンビームエッチングを行った。Fig. 2 は、エッチング深さが約 25 μ m の場合について、エッチング前後の(a) scanning ion microscope (SIM) 像と(b) SEM 像を示したものである。いずれの場合も、予定した場所で、深いトレンチが形成されていることがわかる。また、光学測定によって、この部分で実際に光が反射され、光が導波されていることも確認することができた。





Before etching
(a) SIM image





Before etching After etching
(a) SEM image

Fig. 2. Fabricated trench structure.

4. その他・特記事項(Others)

本課題を支援していただきました筑波大学 微細加工 プラットフォーム 中島清美氏、渡辺英一郎氏に御礼申し 上げます。また、物質・材料研究機構 杉本喜正氏には、 微細加工の議論をいただきました。感謝申し上げます。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。